

LCP 日本杜邦 5145L BK010连接器专用LCP塑胶原料即使留言

产品名称	LCP 日本杜邦 5145L BK010连接器专用LCP塑胶原料即使留言
公司名称	浩正新材料科技（东莞）有限公司
价格	.00/个
规格参数	赛钢POM:连接器专用LCP塑胶原料 PFA铁氟龙:光学镜头COC材料 COC材料:PFA铁氟龙粒子粉末
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶路1号55号楼106室
联系电话	18825708836 13794983753

产品详情

有些塑胶原料会吸湿,并引起尺寸和性能变化;

具有良好的耐辐射照性和化学稳定性,故常用于原子能工业密封材料和仪表零部件。它可加工成形状复杂的制品,薄而口径大的管、薄片、薄膜、电线包皮、热收缩管和化工设备衬里等。

新型工程塑料,可用作耐高温结构材料和电绝缘材料,可与玻璃纤维或碳纤维复合制备增强材料。

日本三井粘结剂QE800E可改善木塑复合材料

6T塑胶材料连接器厂家表示,这种材料一般是用在2.54间距贴片排母,和1.27间距/2.0间距系列排母上。耐焊接温度在260度-290度之间,所以使用这种材料生产的排母连接器成本略高,选择这种材料一般是客户在产品上有质量的要求。

POM具有很低的摩擦系数和很好的几何稳定性,特别适合于制作齿轮和轴承。由于它还具有耐高温特性,因此还用于管道器件(管道阀门、泵壳体)。

塑胶原料的力学性能在长时间受热下会明显下降;

PBT塑胶材料常被用于生产2.54间距180度/90度的排母连接器产品之上,塑料端子壳的耐焊接温度只有200度左右,由于成本相对其它材料低、强度高、耐摩擦等特性,现在这种材料还是有很多客户选择。但是使用这种材料的成型性较差、缩水严重、由于熔化温度较低、过波峰焊时会产生塑料熔化现象。

改性聚醚醚酮有黑色碳纤增强导电聚醚醚酮、红色碳纤增强导电聚醚醚酮、有矿物增强聚醚醚酮、有玻纤增强聚醚醚酮及PEEK树脂。虽然聚醚醚酮具有许多优良性能,但是价格昂贵,限制了其在一些领域的应用。另外,它的冲击强度较差,为了进一步提高其性能,以满足各个领域的综合性能和多样化需要,可采用填充、共混、交联、接枝等方法对其进行改性,以得到性能更加优异的PEEK塑料合金或PEEK

复合材料。例如：PEEK与聚醚共混可得到更好的力学性能和阻燃性；PEEK与PTFE共混制成复合材料，具有突出的耐磨性，可用于制造滑动轴承、动密封环等零部件；PEEK用碳纤维等填充改性，制成增强的PEEK复合材料，可大大提高材料的硬度、刚性及尺寸的稳定性等。

一般塑胶原料在常温下和低于其屈服强度的应力下长期受力,会出现形变;

EEK目前已广泛成熟应用于航天航空、军工、医疗、电子半导体、汽车、石油石化、分析仪器、饮料灌装、电子烟等使用工况和要求苛刻的高端领域，市场需求潜力巨大。

- 1、光学镜头、光学播音器、多边镜、角膜板用保护膜；
- 2、DVD碟片、保护膜、大型显示器、背光导光板、小型显示器前光导光板；
- 3、光学半导体、光学薄膜、医疗器材、汽车配件；
- 4、镜片材料、高像素镜头；
- 5、光纤和分析化学仪器用池/槽。

在制作连接器产品的时候，总会有需要用到塑料材质的时候，连接器将介绍连接器生产时常用的塑料材质有哪些？这些材质又需要满足汽车连接器产品的哪些要求呢？就制作材质来说，连接器常用到的塑料原材料主要有PBT、66、6T、9T、LCP等，而这些材料在质量、耐高温性能以及价格上都是有区别的，当然了，这些区别也会体现在连接器价格之上。

LCP塑胶原料的特性；

- a、LCP具有自增强性：具有异常规整的纤维状结构特点，因而不增强的液晶塑料即可达到甚至超过普通工程塑料用百分之几十玻璃纤维增强后的机械强度及其模量的水平。如果用玻璃纤维、碳纤维等增强，更远远超过其他工程塑料。
- b、液晶聚合物还具有优良的热稳定性、耐热性及耐化学药品性，对大多数塑料存在的蠕变特点，液晶材料可以忽略不计，而且耐磨、减磨性均优异。
- c、LCP的耐气候性、耐辐射性良好，具有优异的阻燃性，能熄灭火焰而不再继续进行燃烧。其燃烧等级达到UL94V-0级水平。
- d、LCP具有优良的电绝缘性能。其介电强度比一般工程塑料高，耐电弧性良好。在连续使用温度200-300，其电性能不受影响。间断使用温度可达316 左右。
- e、LCP具有突出的耐腐蚀性能，LCP制品在浓度为90%酸及浓度为50%碱存在下不会受到侵蚀，对于工业溶剂、燃料油、洗涤剂及热水，接触后不会被溶解，也不会引起应力开裂。

LCP塑胶原料的应用

- a、电子电气是LCP的主要市场：电子电气的表面装配焊接技术对材料的尺寸稳定性和耐热性有很高的要求（能经受表面装配技术中使用的气相焊接和红外焊接）。
- b、LCP：印刷电路板、人造卫星电子部件、喷气发动机零件、汽车机械零件、医疗方面。
- c、LCP加入高填充剂或合金（PSF/PBT/PA）作为集成电路封装材料、代替环氧树脂作线圈骨架的封装材料；作光纤电缆接头护套和高强度元件；代替陶瓷作化工用分离塔中的填充材料。代替玻璃纤维增强的聚砜等塑料（宇航器外部的面板、汽车外装的制动系统）。